

Title (en)

Method of manufacturing of an electrical end-product having a welding or soldering point

Title (de)

Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Endprodukts, welches Löt- oder Schweissstellen aufweist

Title (fr)

Procédé pour fabriquer un produit électrique fini qui présente une zone de soudage ou de brasage

Publication

EP 1278277 A1 20030122 (DE)

Application

EP 02013756 A 20020621

Priority

DE 10133731 A 20010711

Abstract (en)

A package pre-product (41) is manufactured by injecting a plastics package around a connectionless contact piece (23) of an electrical component (21), the plastics being transparent for a defined laser radiation. A cable (10) is inserted through an opening in the package up to the contact piece. A defined laser radiation is supplied onto the package pre-product, to reach the conductor ends (13) of the cable and cause a solder or weld connection to be formed between the contact piece and the conductor ends.

Abstract (de)

Zur Herstellung eines elektrischen Endprodukts wird um einen Anschlussbereich eines elektrischen Bauteils (21) ein Kunststoffgehäuse (16) gespritzt, wobei im Anschlussbereich das Leiterendstück (13) eines Kabels (10) angelötet oder angeschweißt ist. Zur Vereinfachung und Verbilligung des Verfahrens wird vorgeschlagen, zunächst ein Gehäuse-Vorprodukt (41) herzustellen, in dem das Kunststoffgehäuse (16) mindestens um die noch anschlussfreie Kontaktstelle (23) gespritzt wird, wobei ein freier Zugang (40) bis zur Kontaktstelle (23) entsteht. Es wird dabei ein Kunststoff (14) verwendet, der für eine definierte Laserstrahlung transparent ist. Das Kabelende wird mit seinem Leiterendstück (13) durch den freien Zugang (40) ins Gehäuse-Vorprodukt (41) eingesteckt. Dann wirkt die definierte Laserstrahlung auf das Gehäuse-Vorprodukt (41) ein, trifft auf das an der Kontaktstelle (23) befindliche Leiterendstück (13) und erzeugt dort eine gelaserte Löt- oder Schweißverbindung, <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 43/02

IPC 8 full level

H01R 4/02 (2006.01); **H01R 43/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 4/023 (2013.01); **H01R 43/0221** (2013.01); **H01R 4/029** (2013.01)

Citation (search report)

- [DA] DE 19751487 A1 19990602 - PAC TECH GMBH [DE]
- [A] DE 19644121 A1 19970507 - HEWLETT PACKARD CO [US]
- [DA] US 5724730 A 19980310 - TANAKA YOSHIYUKI [JP]

Cited by

KR20180026782A; CN112993609A; CN107925207A; US2018175573A1; US10378968B2; WO2011138465A1; WO2017032574A1; WO2010057793A1; US10892589B2; EP2347234B1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 1278277 A1 20030122; **EP 1278277 B1 20040310**; DE 10133731 A1 20030130; DE 10133731 C2 20030814; DE 50200280 D1 20040415

DOCDB simple family (application)

EP 02013756 A 20020621; DE 10133731 A 20010711; DE 50200280 T 20020621